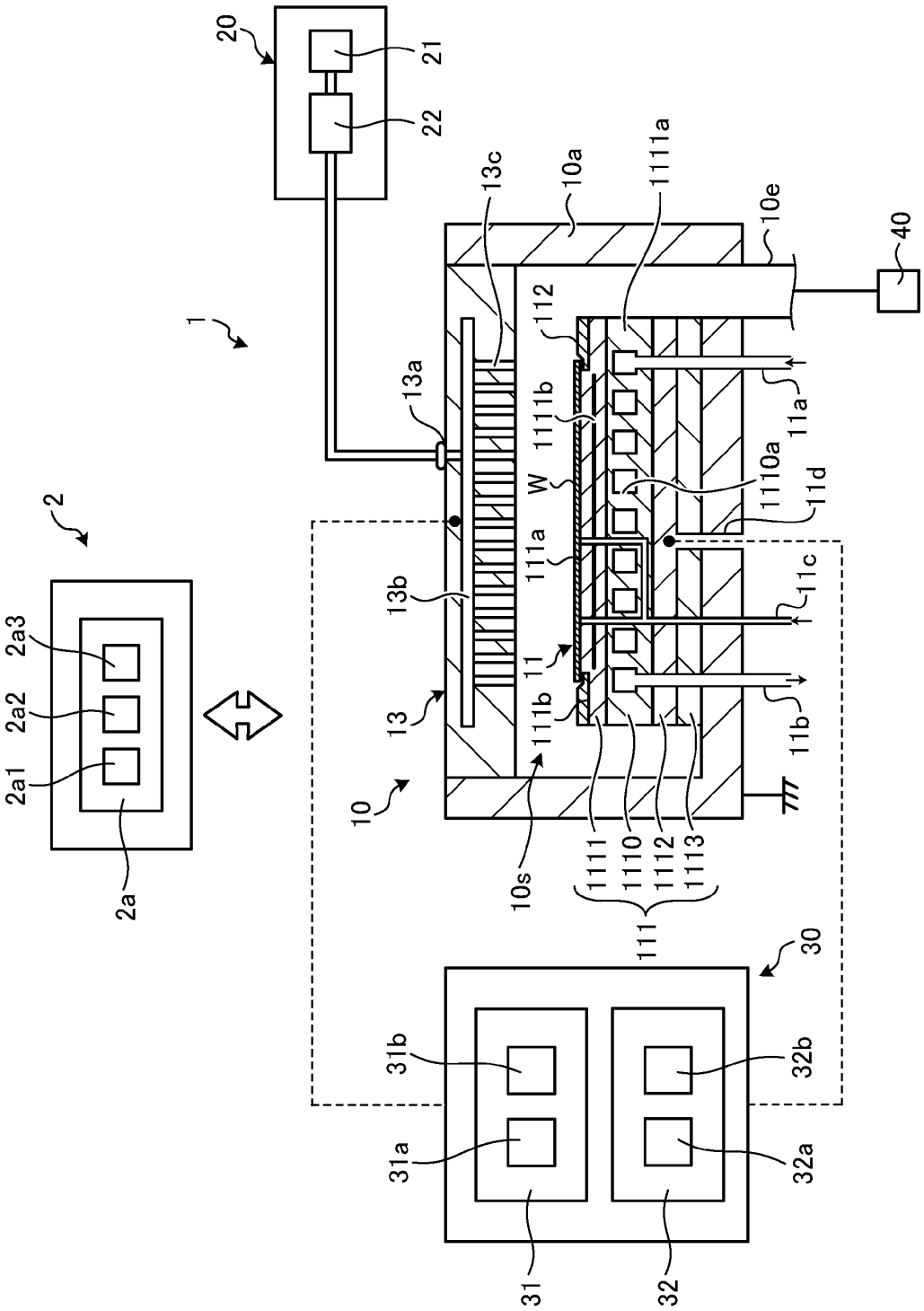
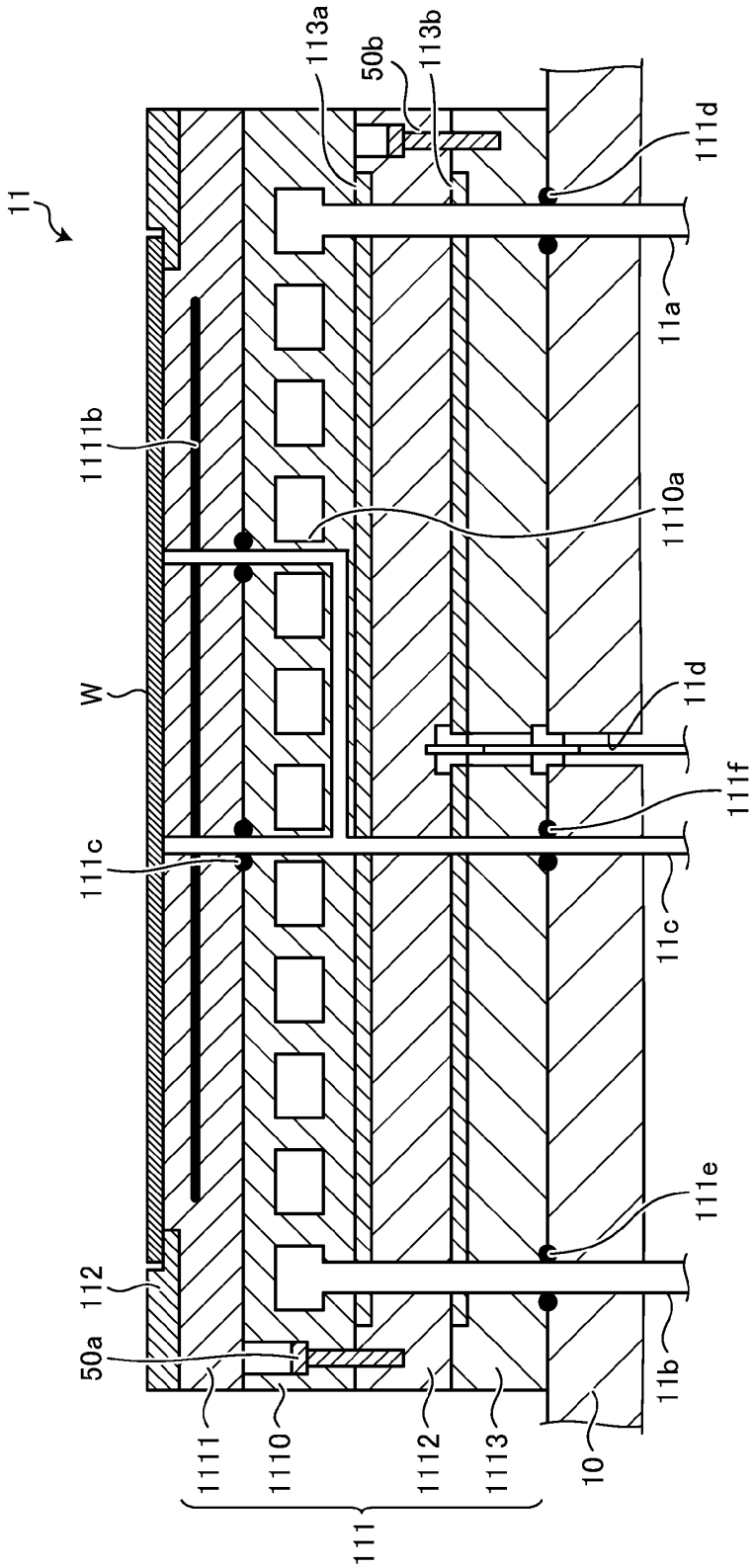
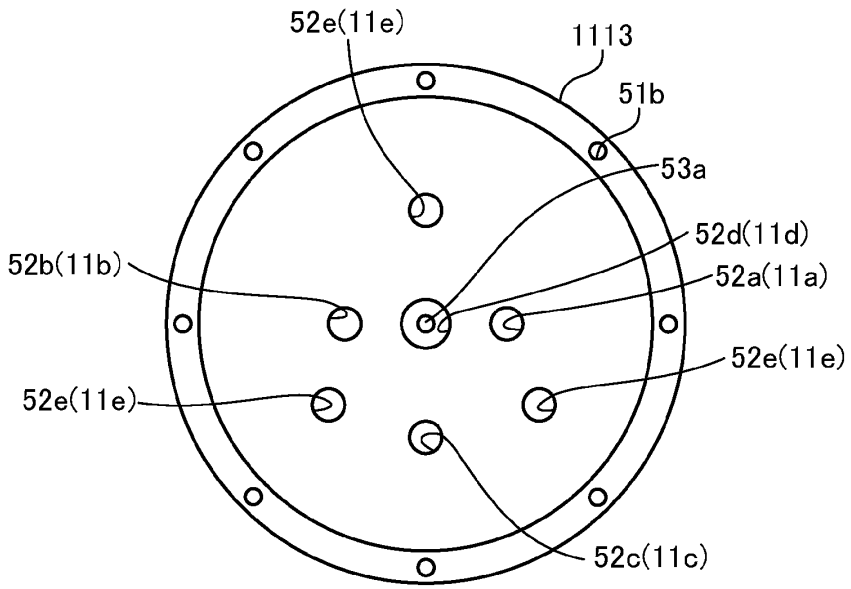
[図1]


20
21
22
1
2
2a3
2a2
2a1
2a
13c
10a
1111a
10e
40
112
13a
1111b
11a
W
1110a
11d
111a
13b
11c
11
13
111b
11b
10
10s
1111
1110
1112
1113
111
30
31b
32b
31a
32a
31
32

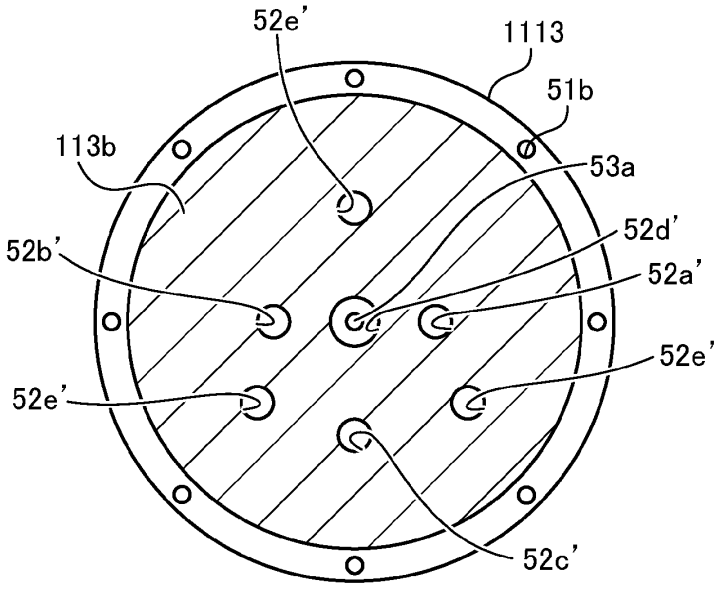
[図2]


11
113a
50b
113b
111d
11a
1111b
1110a
W
11d
111f
111c
11c
111e
112
50a
11b
1111
1110
1112
1113
10
111

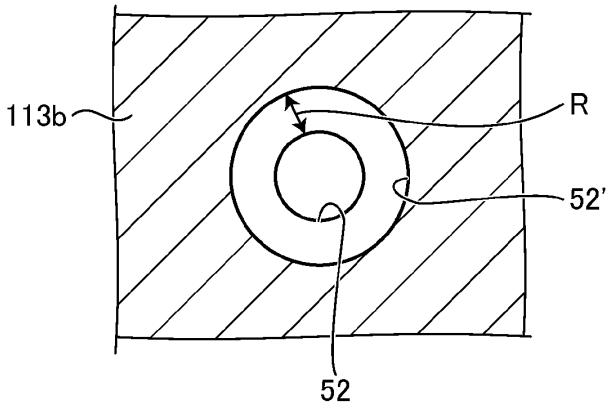
[図3]


52e(11e)
1113
51b
53a
52d(11d)
52b(11b)
52a(11a)
52e(11e)
52e(11e)
52c(11c)

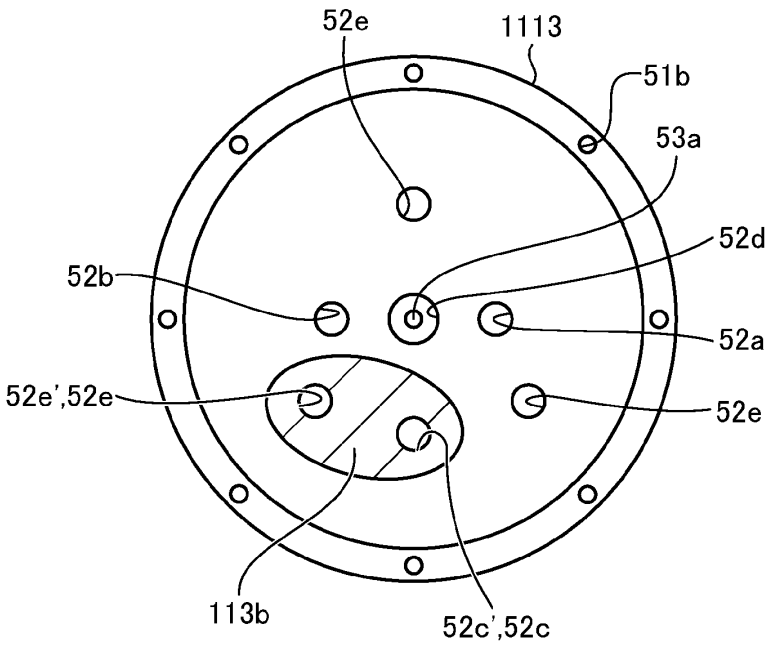
[図4A]



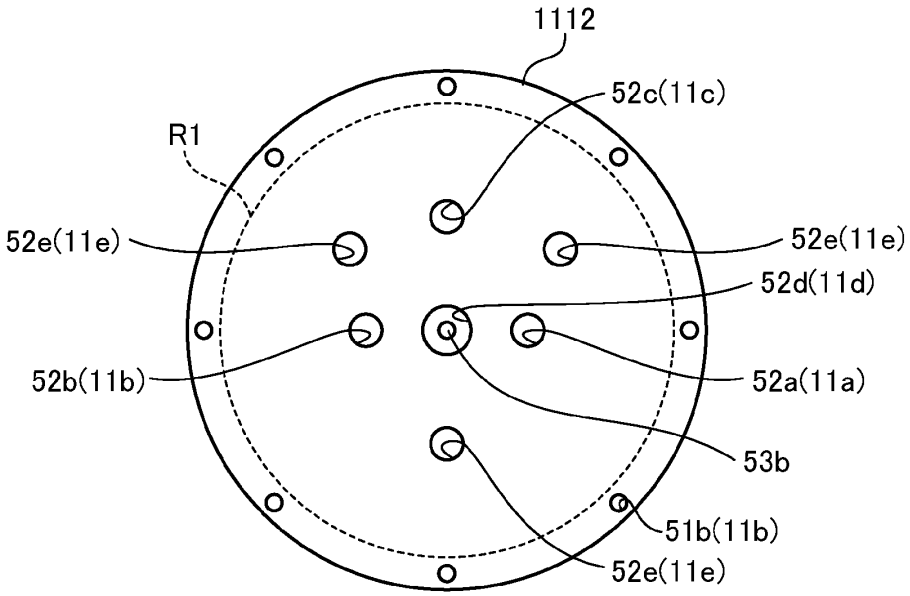
[図4B]



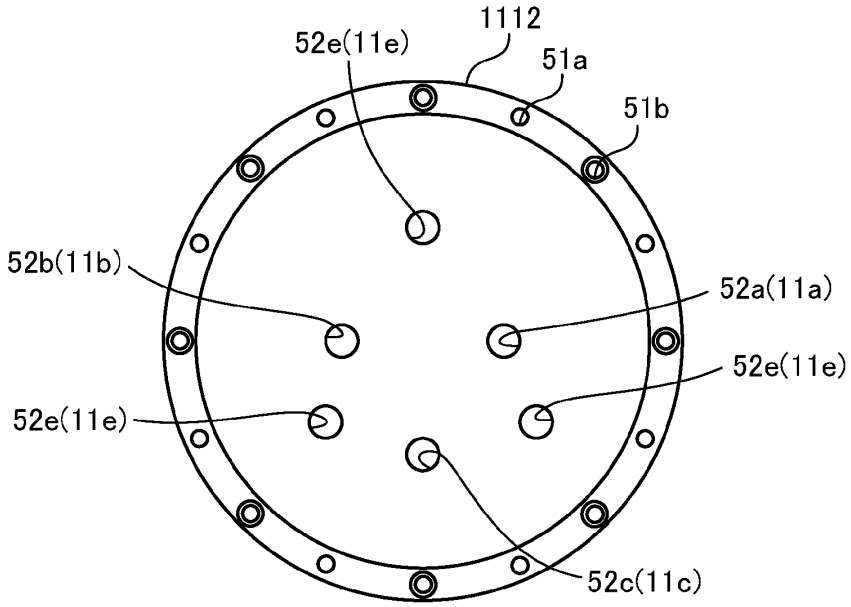
[図4C]



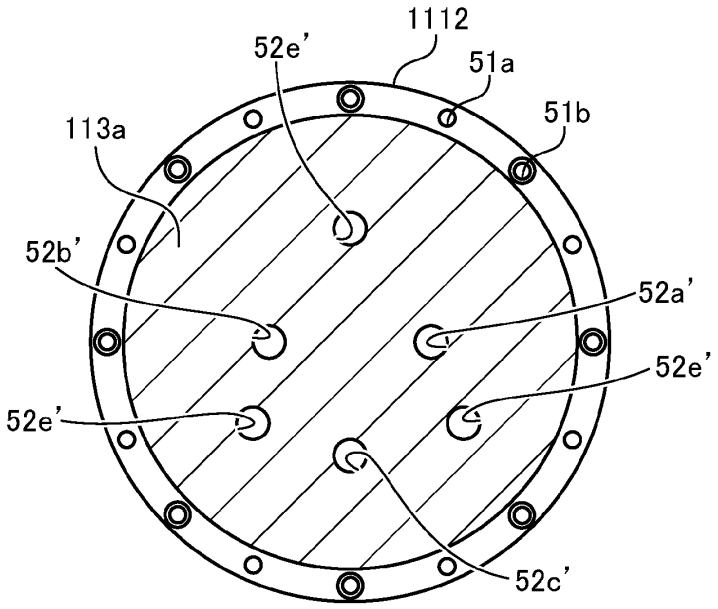
[図5]


1112
52c(11c)
R1
52e(11e)
52e(11e)
52d(11d)
52b(11b)
52a(11a)
53b
51b(11b)
52e(11e)

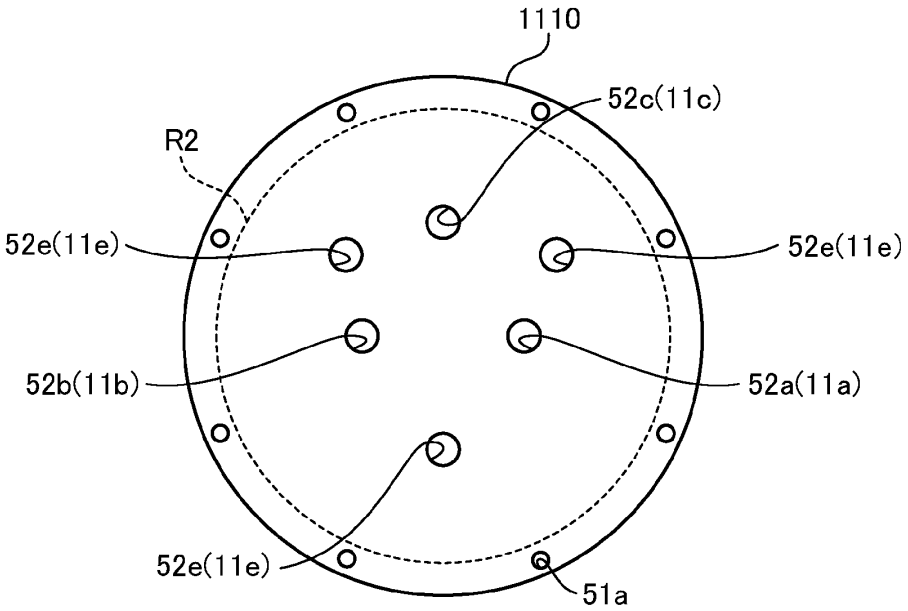
[図6]


1112
52e(11e)
51a
51b
52b(11b)
52a(11a)
52e(11e)
52e(11e)
52c(11c)

[図7]


1112
52e'
51a
51b
113a
52b'
52a'
52e'
52e'
52c'

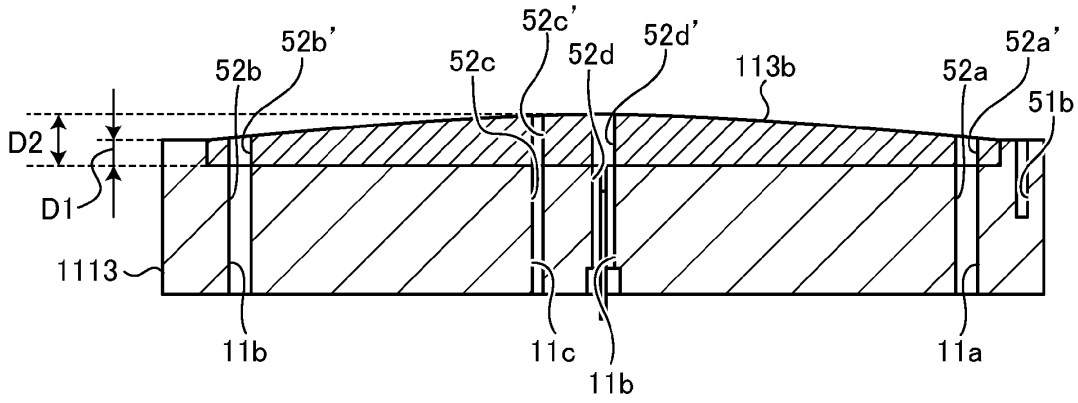
[図8]


1110
52c(11c)
R2
52e(11e)
52e(11e)
52b(11b)
52a(11a)
52e(11e)
51a

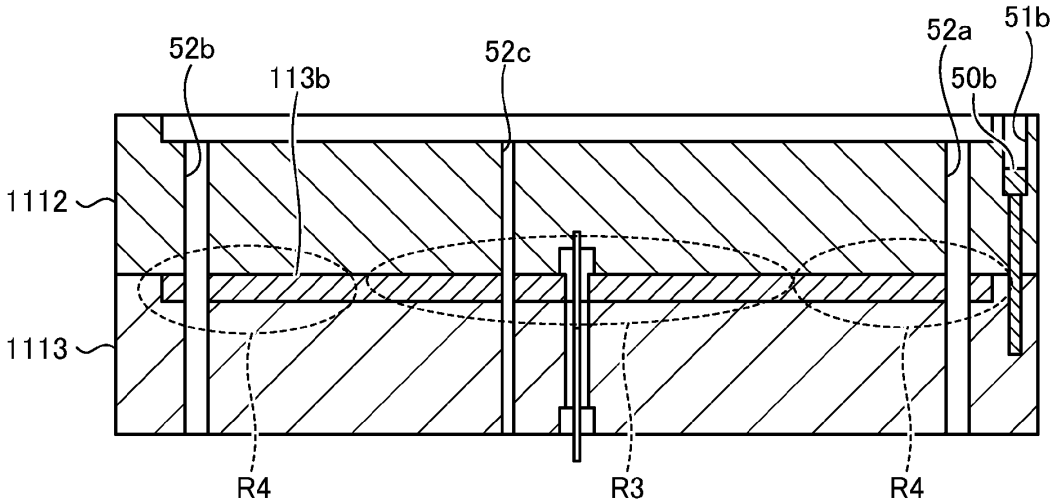
[図9]


スタート
S10
支持台の上面にシール層を配置
S11
シール層が配置された支持台の上にRFプレートを載せる
S12
支持台とRFプレートとを締結
S13
RFプレートの上面にシール層を配置
S14
シール層が配置されたRFプレートの上に基台を載せる
S15
RFプレートと基台とを締結
S16
基台の上にOリングを配置
S17
基台の上に静電チャックを載せる
エンド

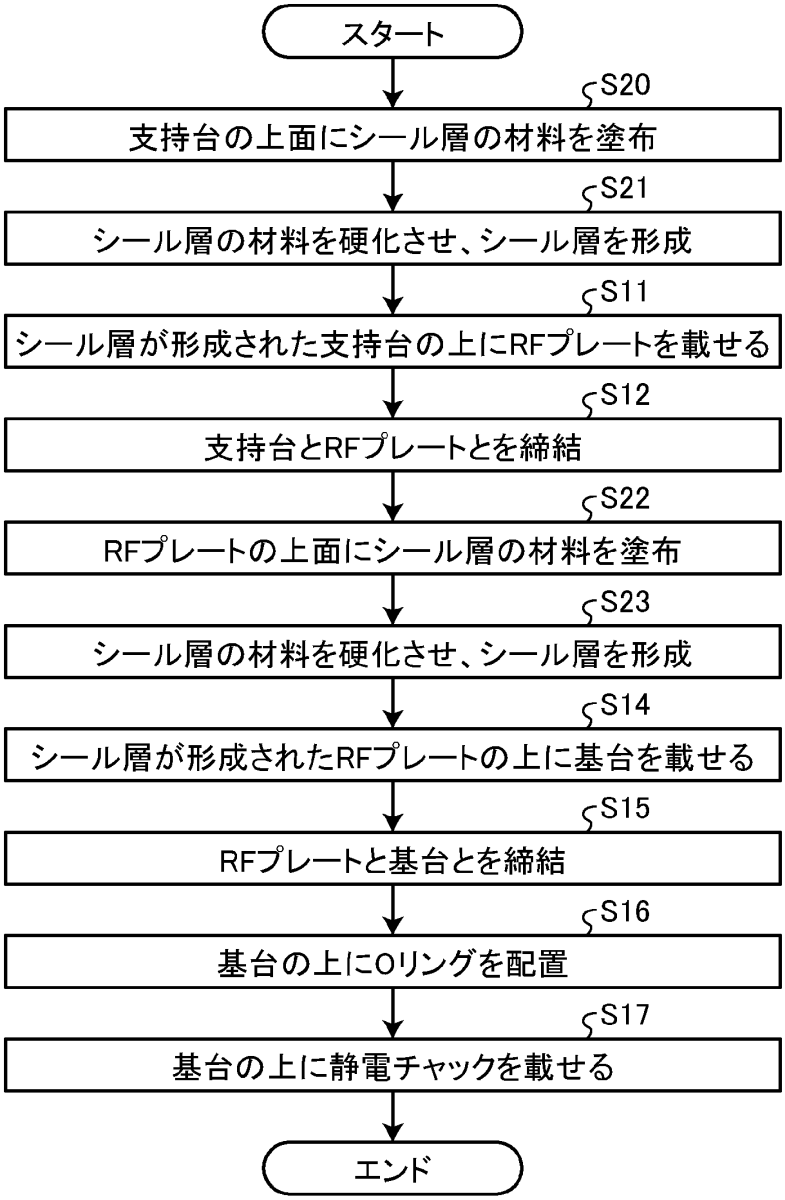
[図10]


52c'
52b'
52d'
52a'
52b
52c
52d
113b
52a
51b
D2
D1
1113
11b
11c
11b
11a

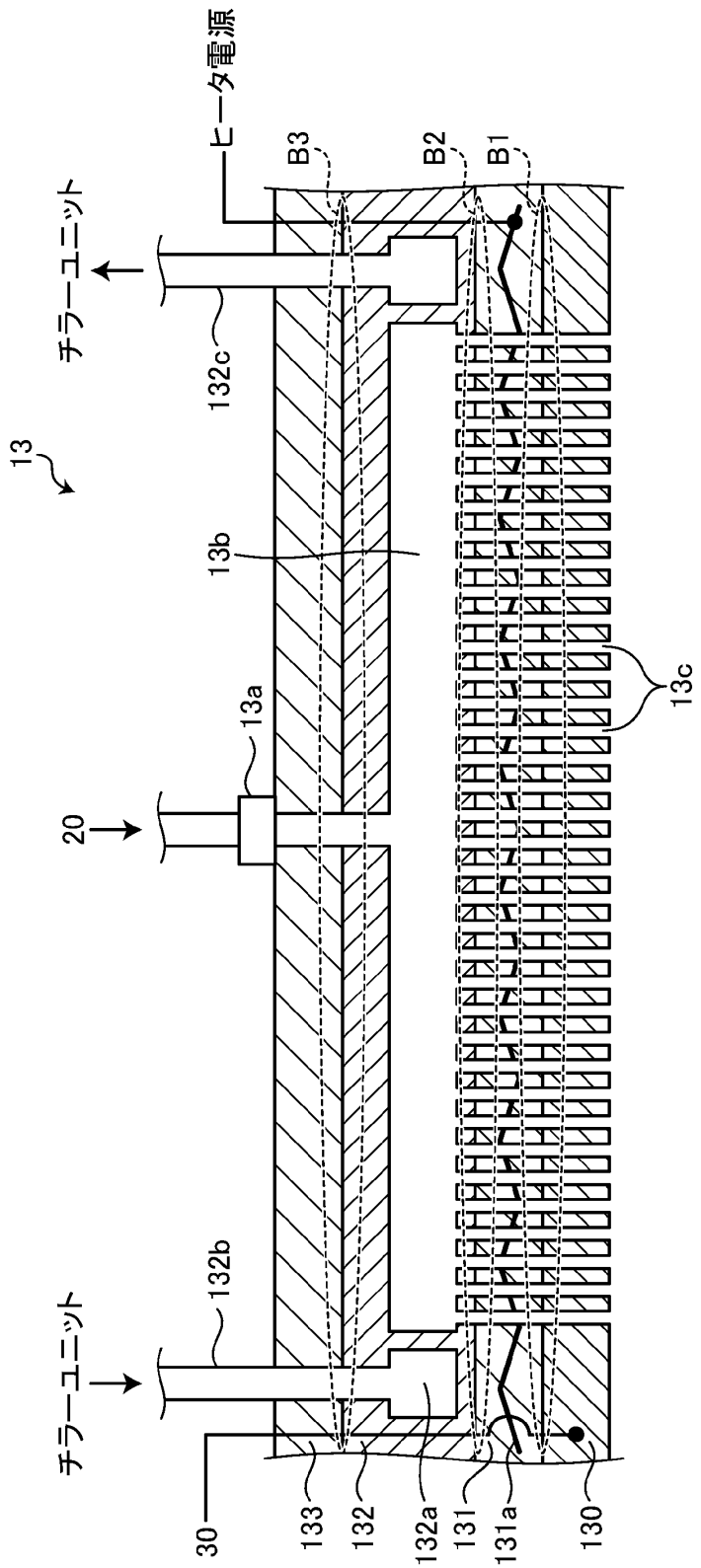
[図11]


52b
113b
52c
52a
51b
50b
1112
1113
R4
R3
R4

[図12]


スタート
S20
支持台の上面にシール層の材料を塗布
S21
シール層の材料を硬化させ、シール層を形成
S11
シール層が形成された支持台の上にRFプレートを載せる
S12
支持台とRFプレートとを締結
S22
RFプレートの上面にシール層の材料を塗布
S23
シール層の材料を硬化させ、シール層を形成
S14
シール層が形成されたRFプレートの上に基台を載せる
S15
RFプレートと基台とを締結
S16
基台の上にOリングを配置
S17
基台の上に静電チャックを載せる
エンド

[図13]


ヒータ電源
B3
B2
B1
チラーユニット
132c
13
13b
13a
13c
20
チラーユニット
132b
30
133
132
132a
131
131a
130